

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

1. 截至民國一〇一一年三月三十一日止，本公司及子公司因進口機器設備已開立但未使用信用狀之金額約為 2 億元。
2. 截至民國一〇一一年三月三十一日止，本公司及子公司主因訴訟及海關稅捐等保證委請金融機構開立之履約保證之金額約為 16 億元。
3. 以本公司及子公司名義簽訂技術授權及智權開發合約之總價款約為 30 億元，截至民國一〇一一年三月三十一日止，尚未認列金額約為 10 億元。
4. 本公司及子公司因營運所需而簽訂之工程合約總價款約為 241 億元，截至民國一〇一一年三月三十一日止，尚未認列金額約為 153 億元。
5. 本公司及子公司與部分客戶簽訂晶圓代工合約，依合約之規定，提供特定產能予該等客戶。
6. 本公司董事會於民國一〇三年十月九日通過決議，與廈門市人民政府及福建省電子信息集團簽訂參股協議書，依協議書約定，本公司與福建省電子信息集團合資成立之公司於福建省廈門市從事半導體製造，提供 12 吋晶圓專工服務。本公司及子公司依此協議於民國一〇四年一月至一〇七年九月經主管機關審查通過分期注資聯芯集成電路製造(廈門)有限公司人民幣 82.8 億元，並取得控制力。另，依參股協議規定，於其餘出資方之出資額全數到位後第 7 年(民國一〇一一年)開始以加計固定收益方式買回其出資份額總計人民幣 48.6 億，本公司已帳列其他金融負債-流動及其他非流動負債-其他。因此，本公司根據國際財務報導準則第 10 號規定於財務報導期間內認列非控制權益。並根據 IFRS 9 規定於每一報導期間結束日，將對其他出資方之承諾認為金融負債，同時沖減非控制權益，差額認列於權益項下。
7. 臺灣臺中地方法院檢察署於民國一〇六年八月三十一日以本公司之受雇人涉嫌侵害 MICRON TECHNOLOGY, INC. (MICRON 公司)之營業秘密為由，依營業秘密法對本公司提起公訴，民國一〇九年六月十二日臺灣臺中地方法院就本公司等人被控告竊取營業秘密案作出有罪判決，本公司依法提起上訴。民國一〇一〇年十一月二十六日本公司與 MICRON 公司簽訂達成全球性和解之協議，爾後 MICRON 公司已遞交書狀表示撤回告訴。民國一〇一一年一月二十七日，上訴法院就本案作出判決，本公司被判處新臺幣 2 仟萬元罰金，緩刑貳年。

MICRON 公司於民國一〇六年十二月五日在美國加州北區聯邦地區法院以本公司侵害其營業秘密為由，提起民事訴訟，主張本公司應賠償 MICRON 公司所受實際損害、三倍損害賠償金及相關費用，並請求法院核發初步及永久禁制令禁止本公司使用其營業秘密。達成全球性和解協議後，法院已於民國一〇一一年一月同意雙方當事人之聲請並裁定駁回對聯電之訴。

本公司於民國一〇七年一月十二日在大陸福州市中級人民法院，對美光半導體(西安)有限責任公司與美光半導體銷售(上海)有限公司等提起三件侵害專利權訴訟，請求法院判令該等被告停止製造、加工、進口、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的行為，銷毀全部庫存及相關模具及工具。大陸福州市中級人民法院於民國一〇七年七月三日對上述兩家被告公司等發出初期禁令，裁定上述兩家被告公司等立即停止製造、銷售及進口侵害本公司專利權之多項產品。法院已批准本公司撤回其中一項訴訟，其他兩項訴訟案仍由法院審理中。達成全球性和解協議後，本公司已向法院遞交撤訴及撤銷保全申請，目前等待法院裁定。